



Obudowy puste

TG PC 88-9-o



TG PC 88-9-o

Obudowy puste

KONFIGUROWALNY

84 x 82 x 85 mm

Numer artykułu: 20090301

Obudowa pusta – jakość przemysłowa, Skrzynka i pokrywa: poliwęglan, szary, podobny do RAL 7035, z zatrzaskiem, z zabezpieczeniem zamknięcia pokrywy

IP67
IP66

IK08



690V
AC

1000V
DC



Dane techniczne

Środki

Szerokość:	84 mm
Długość:	82 mm
Wysokość:	85 mm
Wysokość wnętrza:	69 mm

Material:

Skrzynka:	poliwęglan, szary, podobny do RAL 7035
Pokrywa:	poliwęglan, szary, podobny do RAL 7035
Uszczelka:	Poliuretan
Śruba do pokrywy:	Stal nierdzewna V2A, zatrzask
Materiał:	Poliwęglan

Akcesoria

DAE M12 - Element do kompensacji ciśnienia

LFR - Wiertło stopniowe

NS 35-66 - Szyna znormalizowana

TG ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

TG DVS-42 - Deckelverliersicherung

TG MPI-88 - Płyta montażowa

TG MPS-88 - Płyta montażowa

TG PST1 - Zestaw do plombowania

TS 15-66 - Szyna znormalizowana



Obudowy puste

TG PC 88-9-o

Inne atrybuty

Rodzaj ochrony:	IP66/IP67 – wg EN60529 / DIN VDE 0470-1
Wytrzymałość udarowa:	IK08 wg DIN EN 5012 / VDE 0470 cz. 100
Stopień ochrony:	II – izolacja ochronna wg VDE 0106
Temperatura otoczenia (minimalna):	-35 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	80 °C
Temperatura otoczenia (24 godziny):	60 °C
Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Nie zawiera metali ciężkich:	Tak
bez PCW:	Tak
nie zawiera silikonu:	Tak
Wpusty przewodów:	Nie
Badanie palności wg UL 50 / UL 746C:	5VA nach UL 50 / UL 746C
Badanie palności wg UL 94:	V-2 wg UL 94
Badanie palności wg VDE:	960°C wg VDE 0471/ EN 60695
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	95%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%
Odporność na warunki atmosferyczne:	tak - wg. UL 746 C